

回路修正サービス

当社では集束イオンビーム加工装置(FIB加工装置)を使用した回路修正サービスを提供しています

- ・ デバイスの内部信号を観察したい。
- ・ マスク改版前に回路修正内容の有効性を確認したい。
- ・ マスク改版を行わないで、特性の違うサンプルを作成したい。

などのご要望に対応いたします。

FIB加工装置で出来ること

1. 絶縁膜を削る
2. 配線(アルミ, 銅)を削る
3. 導体を成膜する
4. 絶縁膜を成膜する

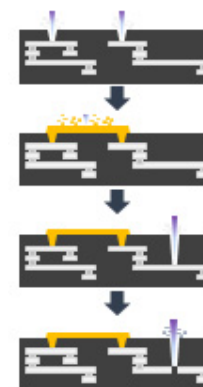
当社が所有するFIB加工装置は回路修正に特化した仕様となっており6種類のガスを搭載、加工内容に合わせてガスを使い分けることにより高速かつ精度よく回路修正を行うことができます。

その他にも以下に対応しております。

- ・ Cu配線、Low-K膜に対応
- ・ 各種パッケージ、ウェーハー(6,8インチ)、チップ状態での加工に対応
- ・ CADデータ(GDS II フォーマット)を使用した加工位置へのナビゲーション
- ・ ICパッケージ開封、ポリイミド剥離などの前処理からFIB加工まで一貫した作業を請け負うことも可能

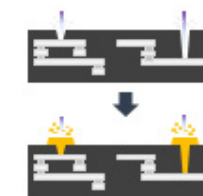
回路修正

- ① 接続対象配線を露出
(絶縁膜ミリング用ガスを使用)
- ② 2つの配線を接続
(導体デポジションガスを使用)
- ③ 切断対象配線を露出
(絶縁膜ミリング用ガスを使用)
- ④ 露出した配線を切断
(メタルミリング用ガスを使用)



パッド作製

- ① 対象配線を露出
(絶縁膜ミリング用ガスを使用)
- ② 導体を埋込、パッドを形成
(導体デポジションガスを使用)



回路修正サービスのご相談、ご依頼は下記までお願いいたします。

✉ TEDS-fa-service@ml.toshiba.co.jp

東芝デバイスソリューション株式会社

© 2025 Toshiba Electronic Device Solutions Corporation